

证券代码：301200

证券简称：大族数控

深圳市大族数控科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中泰证券
时间	2024年7月12日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 证券事务代表：周鸳鸳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司的新产品布局</p> <p>去年以来，公司已完成压合系统、在线双面光学检查机等新产品的研发，进一步拓展了关键工序的覆盖，加上涂层刀具产品的引入，业务范围跨入真空压合设备、光学检测设备及材料领域，为公司开拓全流程一站式场景解决方案做有力铺垫。</p> <p>另外，在已布局的工序及产品方面，公司持续推动跨越性升级，如十二轴机械钻孔机、四光束 CO₂ 激光钻孔机、应用 AOD 技术的 UV 激光钻孔机、十六倍密通用高精测试机等，为 PCB 行业提供效率更高、综合成本更低的降本增效或提质增效解决方案，助力下游客户提升综合竞争力。</p> <p>二、HDI 市场及 IC 封装基板领域进展</p> <p>面对 HDI 市场应用场景日渐增加，其技术难度不断提升，如叠层数增加、盲孔孔径减小及密度增加、高频高速材料的应用等，公</p>

司推出诸多技术升级产品，包含高转速主轴机械钻孔机、四光束 CO₂ 激光钻孔机、UV+CO₂ 复合激光钻孔机、L/S 12/12μm 高解析度激光直接成像机、CCD 六轴独立控制机械成型机、定位精度±5μm 高精专用测试机等，并针对不同需求提供个性化的解决方案，已在国内多家知名 HDI 企业获得批量订单，产品市场占有率进一步攀升。

公司一直以来紧紧围绕国内封装基板龙头客户的需求进行产品研发，推出的高转速载板专用机械钻孔机获得国内多家龙头客户的认证，可满足 BT 载板及 FC-BGA 载板小孔径的高精度加工；创新运用新型激光技术，开发出用于玻璃基在内先进封装基板的加工方案，包括极小直径钻孔、盲槽及内埋高精度元器件锣槽等工艺的应用，广泛获得国内外封装基板厂商的技术认证及顶级终端客户的认可；研发的封装基板高精专用测试及 FC-BGA 单片测试设备，具备对标龙头企业 Nidec-Read 主流机型的能力。

三、海外市场情况

PCB 制造企业海外布局进展加速，特别是泰国、越南等东南亚地区诸多项目进入设备评估阶段，公司积极拓展海外市场，推进海外公司设立，建立本土化的运营团队，及时满足客户的购机或技术支援需求。目前已与从中国大陆出海到东南亚国家的多家 PCB 企业达成合作意向，随着下游客户东南亚项目的陆续落地，公司海外市场的销售额有望显著增长。

四、公司的发展规划

一方面，公司将持续深挖多层板市场价值，加大创新研发力度，打造超越客户预期的优化解决方案，并通过产业链上下游价值发现机制，不断拓宽公司产品矩阵，持续放大公司在该市场的价值；另一方面，公司聚焦市场增速快、技术门槛更高的 HDI 板、IC 封装基板、挠性板及刚挠结合板等领域，发挥多产品、多场景的协同优势，研发适应不同细分市场需求的、具有市场竞争力的覆盖 PCB 生产全流程的智能制造解决方案，不仅要从产品性能层面打破国外的技术垄断，更要从 PCB 全流程智造的维度实现对国外技术的赶超。

附件清单（如有）

无

日期

2024 年 7 月 12 日